## 474 半導體元件物理與製程——理論與實務

可程式化邏輯元件(PLD) 386

可變電容器 (Varactor) 41,337,349

可變電容器 (variable reactor) 41,337,349

失真 (distortion) 290, 340, 450, 456-457

平均橫貫電場 (average traverse field) 149

平帶狀態 (flat-band condition) 79,83,98-100,109-110,117

平帶電壓 (flat-band voltage) 99-100, 109-116, 281

本質半導體 (intrinsic semiconductor) 6-8, 11, 13, 24, 81, 84

本質費米能階 (intrinsic Fermi level) 6-7, 11, 13, 24, 33, 77, 81

本質載子密度(intrinsic carrier density) 6

本質載子濃度 (intrinsic carrier concentration) 2, 5-6, 8-9, 11, 13

本體貫穿(bulk punch-through) 174

未飽和鍵結(unsaturated bondings) 99

未摻雜多晶砂 (undoped Poly-Si) 200

正反器(Flip-Flop) 306-308, 314, 356

## 六劃

交換器(switch) 397, 399-400, 407, 409

光阻 (photoresist, P.R.) 102, 189-192, 196, 200-205, 208, 210-211, 215, 226

光阻塗佈 (P.R. coating) 190

光罩式唯讀記憶體 (Mask Read Only Memory; Mask ROM) 386

全客戶設計 (full custom design) 386

全面性應變 (global strain) 265, 268-269

共源極 (common source, CS) 323-325, 331

共價鍵結 (covalent bonding) 8-9, 11

共價鍵結模型 (covalent bonding model) 11

再充電 (refresh) 356

再補充 (refresh) 366

同步 (synchronous) 95, 300, 307, 328-329, 356, 363, 395

合成器 (synthesizer) 336,338

回火 (anneal) 104, 106, 108-109, 146, 199, 201, 205, 229, 242

多工器 (multiplexer, 簡寫 MUX) 304-305

多媒體 (multimedia) 392, 394-396, 398-400, 402-403, 409

多晶矽 (ploy-Si) 123, 188, 194-196, 200-202, 215, 233, 236-239, 244, 281-283, 334, 356, 363-364, 368, 431-432, 435, 437-441

多晶砂空乏 (poly-depletion) 236, 238, 281

多晶矽閘極 (poly-Si gate) 188, 195-196, 200, 202, 215, 237